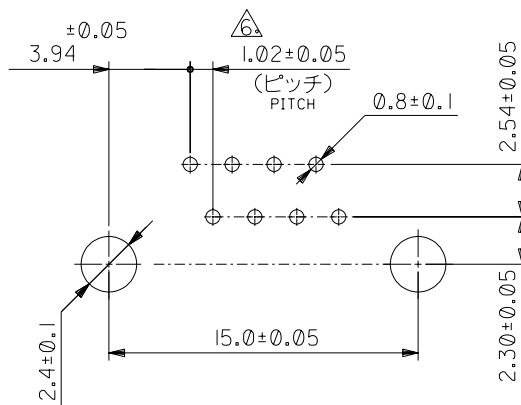
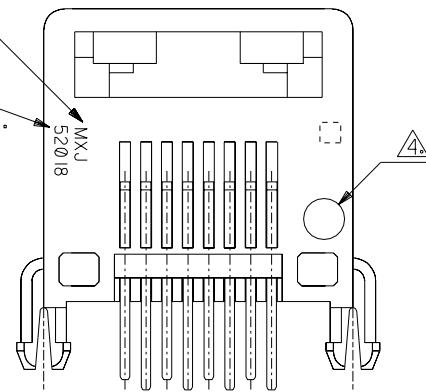
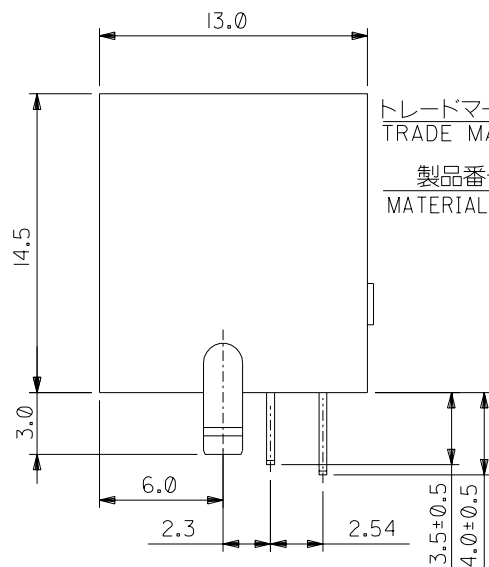
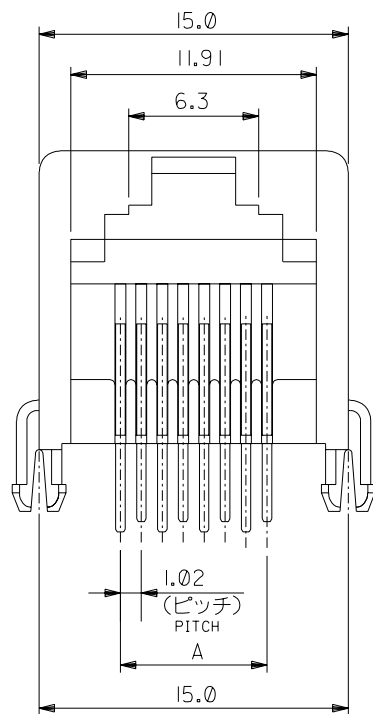
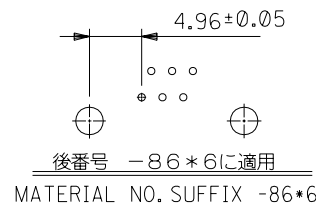
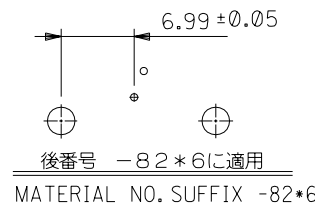




後番号 -88*6に適用
MATERIAL NO. SUFFIX -88*6



後番号 -86*6に適用
MATERIAL NO. SUFFIX -86*6



後番号 -82*6に適用
MATERIAL NO. SUFFIX -82*6

基板穴推奨寸法
RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
(ジャック取付け側)

角度	ANGLE	±3°
30°以上	OVER	±0.3
10°以上 30°未満	OVER UNDER	±0.25
10°未満	UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES		

52018-8**6	POSITION	極数	(A)	金メッキ厚(μmMIN.) GOLD PLATING THK(MIN.)	製品番号 MATERIAL No.
MODEL NO.	CIRCUITS				
8	7.11	1.27	52018-8846		
		0.76	-8836		
		0.38	-8826		
		0.1	-8816		
6	5.08	1.27	-8646		
4	3.05	1.27	-8446		
2	1.02	1.27	52018-8246		
材料 注参照 MATERIAL SEE NOTES					
仕上げ 注及び表参照 FINISH SEE NOTES AND CHART					
適用電線範囲 WIRE RANGE					
被覆外径 INS. RANGE					
DRAWN BY '04/04/28 M.NABEI					
CHK'D BY '04/04/28 K.TOJO					
APP'D BY '04/04/28 M.SASAO					
REVISION RECORD					
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM					

注) NOTES

- 材質 MATERIAL
ハウジング: ガラス入りポリエステル UL94V-0
HSG.: POLYESTER G.F.15% UL94V-0
ターミナル: リン青銅
TERM.: PHOSPHOR BRONZE
- メッキ仕様 PLATING
接点部: 金メッキ、表参照
CONTACT AREA: GOLD PER TABLE
半田付け部: 錫メッキ 1.0μmMIN.
SOLDER AREA: TIN 1.0μmMIN.
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.0μmMIN.
UNDERPLATE: NICKEL 1.0μmMIN.
- 推奨基板厚: t=1.6±0.05
RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS: 1.6±0.05
- 金メッキ厚標示
COLOR CODING TO INDICATE GOLD PLATING
黄色: 0.1μmMIN. 緑色: 0.38μmMIN.
YELLOW: 0.1μmMIN. GREEN: 0.38μmMIN.
オレンジ色: 0.76μmMIN. 無色: 1.27μmMIN.
ORANGE: 0.76μmMIN. UNMARKED: 1.27μmMIN.
- ハウジングの色は、グレイ。
HOUSING COLOR IS GRAY.
- 公差非累積。
NON-ACCUMULATIVE
- 本製品は 52018-8**5 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52018-8**5.